

证券代码：300661

证券简称：圣邦股份

公告编号：2025-098

圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司及其子公司（合并报表范围内的子公司，以下统称“子公司”）在2025年拟向银行申请不超过人民币14亿元的综合授信额度。授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议相同事项的董事会召开之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《关于2025年度向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-017）。

一、公司向银行申请综合授信概况

1、公司与招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行”）签署授信额度为人民币伍亿元的《授信协议》，授信期间为12个月。授信额度项下授信业务品种包括但不限于贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、国际/国内保函、海关税费支付担保、法人账户透支、衍生交易、黄金租赁等一种或多种授信业务。

2、公司与中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行（以下简称“工商银行”）签署流动资金借款额度为人民币壹亿元的《流动资金借款合同》。公司应将借款用于公司日常经营周转，借款期限为12个月。

本次签署的《授信协议》及《流动资金借款合同》均不涉及担保事项。公司在授信额度内的实际融资金额以公司实际向银行申请的融资金额为准，公司将在定期报告中披露实际融资的金额。

二、备查文件

- 1、公司与招商银行签署的《授信协议》；
- 2、公司与工商银行签署的《流动资金借款合同》。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日